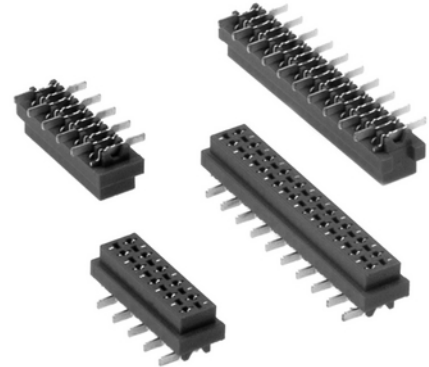


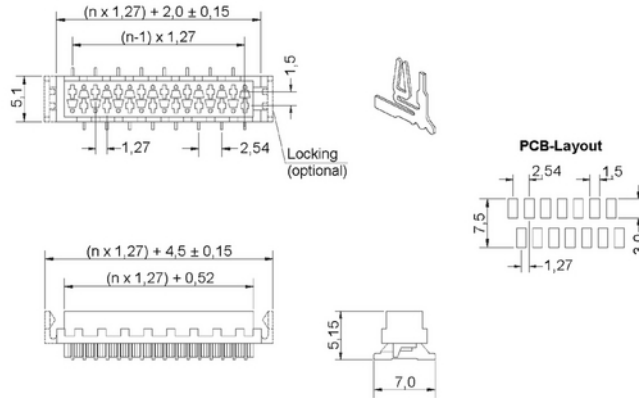
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Farbe <i>Colour</i>	Rot <i>Red</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphorbronze, verzinkt <i>Phosphor bronze, tin plated</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V <sub>RMS</sub> <i>500V<sub>RMS</sub></i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V <sub>RMS</sub> <i>100V<sub>RMS</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1,5A <i>1.5A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C <i>-40°C ... +105°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>

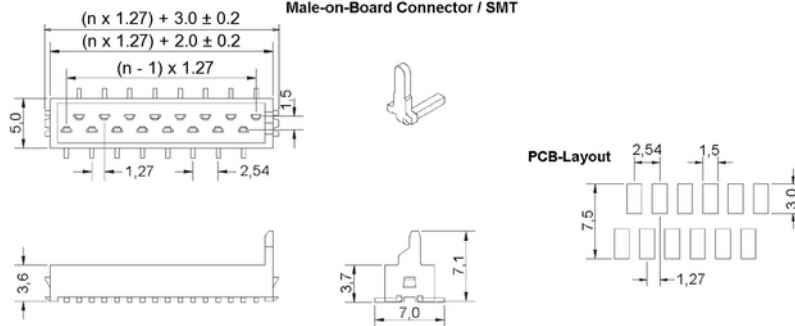


© W+P PRODUCTS

Female-on-Board Connector / SMT



Male-on-Board Connector / SMT



Series	Type*	Contacts*	Locking (Optional)*	Packaging*
<b>6990</b>	<b>5</b> 5 Buchse <i>Female-on-board</i> 6 Stiftleiste <i>Male-on-board</i>	<b>02</b> 04/06/08/10/12/ 14/16/18/20	<b>1</b> (0) Ohne Rast-Clip <i>W/o lock</i> 1 Mit Rast-Clip <i>With Lock</i>	<b>FTR</b> ST TR FTR PPST PPTR

### Lieferformen / Packaging Options:

- ST In Stangen / *In tubes*
- TR Tape & Reel / *Tape & Reel*
- FTR Tape & Reel, mit Folien-Pad / *Tape & Reel, with film tape*
- PPST In Stangen mit Pick&Place-Pad / *In tubes with Pick&Place-Pad*
- PPTR Tape & Reel mit P&P-Pad / *Tape & Reel mit P&P-Pad*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

